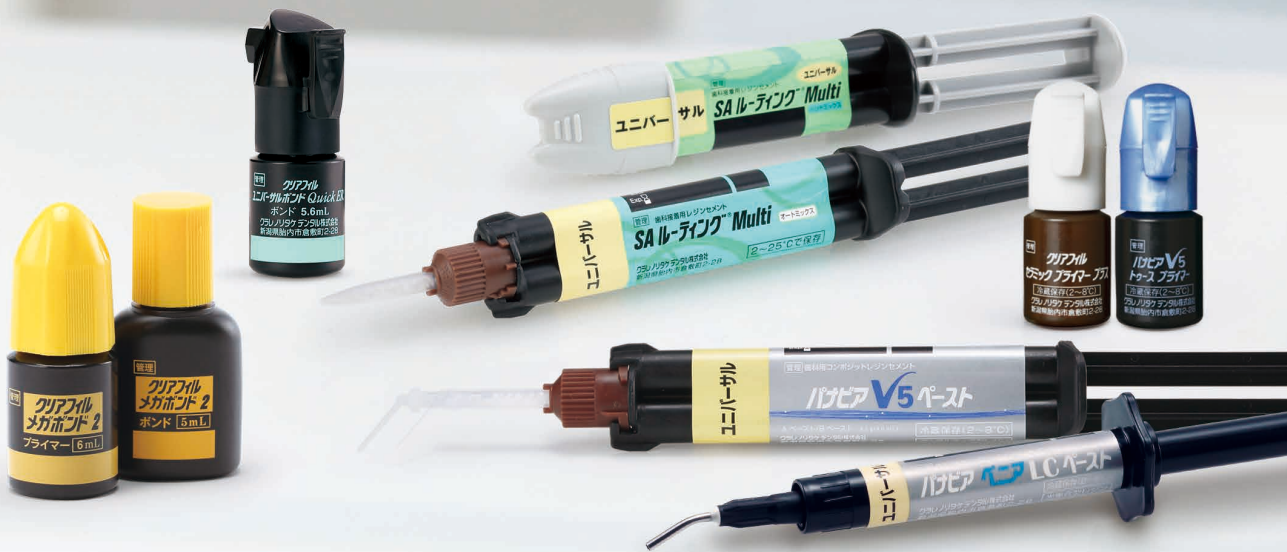


使用用途別

早わかり フローチャート



直接充填

セメント
接着

支台築造

リペア

知覚過敏の
処置

歯面
コーティング



ご使用前には、必ず製品の添付文書及び取扱説明書に記載の使用方法・注意事項をお読みください。

目次

清掃	被着体の清掃 P3~6
直接充填	1 光重合型コンポジットレジンの充填 P7,8
セメント接着	2 CAD/CAMLレジン冠の接着 P9,10
	3 ジルコニアクラウンの接着 P11,12
	4 ラミネートベニアの接着 P13
	5 インプラントアバットメントへの補綴装置の接着 P14,15
	6 金属冠、前装冠の接着 P16
	7 レジンコアの接着 P17,18
	支台築造
9 直接法レジンコア【ファイバーポスト】 P21,22 (デュアルキュア型/セルフキュア型 支台築造用レジン)	
10 直接法レジンコア【金属ポスト】 P23	
11 間接法レジンコアの作成【ファイバーポスト】 P24	
12 セメントによるファイバーポストの植立 P25,26	
リペア	13 口腔内リペア【歯質を含む場合】 P27
	14 口腔内リペア【歯質を含まない場合】 P28
知覚過敏の 処置	15 知覚過敏の処置 P29~31
	16 形成象牙質の処置 P32
	17 各種処置後のしみ止め P33
歯面コーティング	18 象牙質レジンコーティング P34

製品別索引

	直接充填	セメント接着	支台築造	リペア	歯面コーティング	その他
カタナ® クリーナー 		P3,4,5,6				
クリアフィル® メガボンド® 2 	P7		P19			P27
クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER 	P8	P10, 12, 17	P18, 20, 21, 24	P25	P32	P28
パナビア® V5 		P9, 11, 13, 16	P23			
SA ルーティング® Multi 		P10, 12, 14, 15, 17	P24			
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE 			P18, 21, 22			
ティースメイト® ディセンシタイザー 						P29, 30
ティースメイト® APペースト 						P31

○照射器の分類と光量の関係について、特に記載のない場合は以下の表を参照ください。

分類	光量
高出力LED照射器	1500mW/cm ² 以上
LED照射器	800～1400mW/cm ²
ハロゲン照射器	400mW/cm ² 以上

光量について使用する各照射器の添付文書をご確認ください。

- 「クリアフィル」、「メガボンド」、「マジエスティ」、「SAルーティング」、「パナビア」、「オートミックス」及び「ティースメイト」は株式会社クラレの登録商標です。
- 「カタナ」は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

被着面の清掃で本来の接着力を！

接着の前に「カタナ® クリーナー」



接着前の血液や唾液、仮着材・仮封材の残留物などによる、歯質・補綴装置への汚染を清掃

塗布

10秒以上
擦り塗り

水洗※1・
乾燥

接着操作

被着面の清掃

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、防湿等を行ってください。

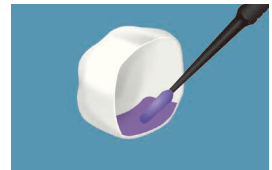
歯質

▶ 歯面に「カタナ® クリーナー」を
10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥



補綴装置

▶ 補綴装置に「カタナ® クリーナー」を
10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥
※試適後にサンドブラストする場合は不要



接着操作

セメント接着



パナビア® V5



SAルーティング® Multi

接着操作



クリアフィル®
ユニバーサルボンド
Quick ER

セメント接着



SAルーティング® Multi

CR充填



クリアフィル®
マジェスティ® ESフロー



クリアフィル®
マジェスティ® ES-2

支台築造



クリアフィル®
DCコア オートミックス® ONE

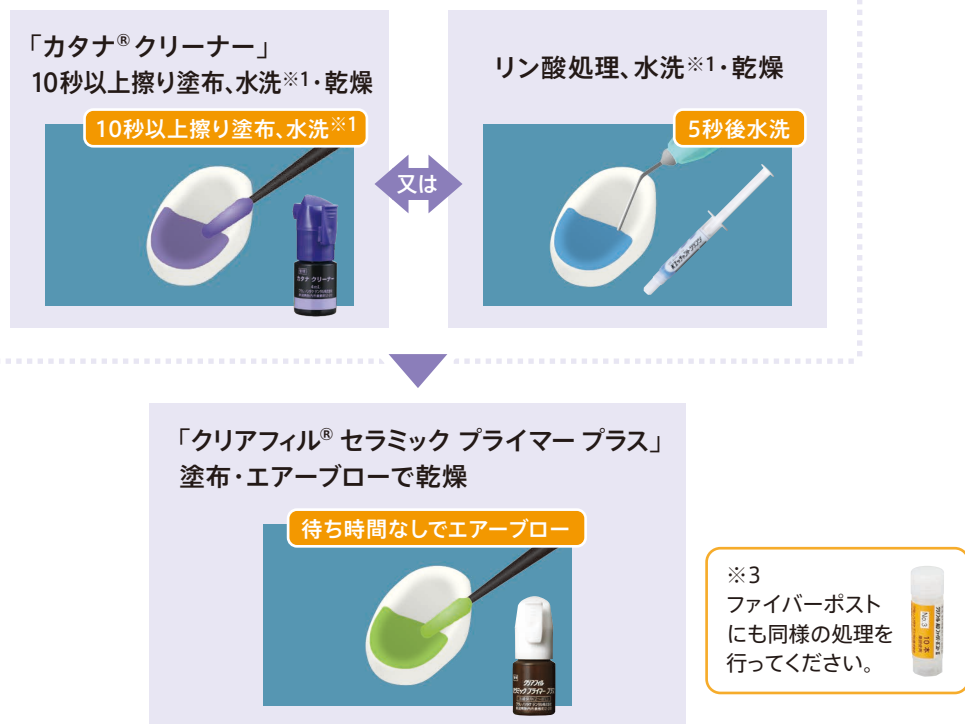
※併用する歯科用接着材については、「カタナ® クリーナー」の添付文書にしたがってください。

補綴装置の操作手順

「カタナ® クリーナー」を使用する場合のシラン処理操作※2, ※3

※2 使用する補綴装置の添付文書にしたいが、必要に応じてサンドブラストを行ってください。

汚染された被着面の清掃



補綴装置にサンドブラストする場合の手順

試適 を いつ行うか がポイントです。

〈例1〉

サンドブラスト → **試適** → 「カタナ® クリーナー」10秒以上擦り塗布 → 接着操作
洗浄・乾燥 水洗※1・乾燥 (シラン処理含む)

〈例2〉

試適 → サンドブラスト → 接着操作
洗浄・乾燥 (シラン処理含む)

「カタナ® クリーナー」での清掃は必要ありません。

※1 色が完全になくなるまで水洗してください。

ジルコニアクラウンの接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、防湿を行ってください。



カタナ® クリーナー



パナビア® V5

1 試適、被着面の清掃

「カタナ® クリーナー」
10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥

10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥

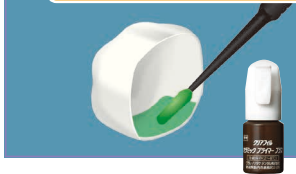


試適後サンドブラストする場合は実施不要

2 シラン処理

「クリアフィル® セラミックプライマープラス」塗布・エアブローで乾燥

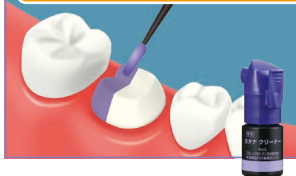
待ち時間なしでエアブロー



3 清掃

「カタナ® クリーナー」
10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥

10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥



4 「パナビア® V5 トゥースプライマー」塗布※2、20秒処理後エアブローで乾燥

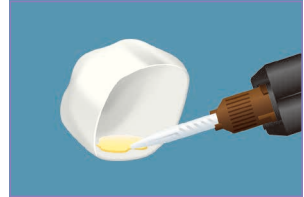
20秒処理後エアブロー



5 クラウンまたは窩洞内にペースト塗布

操作時間

操作時間(23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間(37℃)	60秒



6 装着・余剰セメントの除去

光照射で半硬化させる
除去法

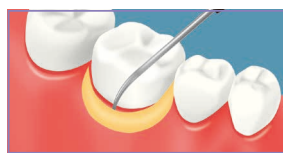
又は
小筆による除去法

1 余剰セメントに1ヶ所につき
3~5秒光照射



3~5秒
オ×ク

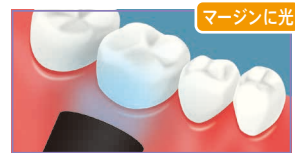
2 探針等で除去



1 余剰セメントを小筆等で
除去



2 マージン部に光照射



マージンに光

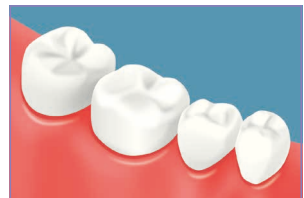
・オペークの場合は小筆による除去法で除去してください。
・光照射については下記表をご参照ください。

7 最終硬化(3分保持)※3

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。



POINT

- ※1 色が完全になくなるまで水洗してください。
- ※2 支台歯(歯質、レジンコア、メタルコア)の一括処理が可能です。
- ※3 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。ただし、オペークは光照射での最終硬化は行えません。

CAD/CAMレジン冠の接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、防湿を行ってください。



カタナ® クリーナー



クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER



SA ルーティング® Multi

1 試適、被着面の清掃 「カタナ® クリーナー」 10秒以上擦り塗布、 水洗※1・乾燥

10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥



試適後サンドブラストする場合は実施不要

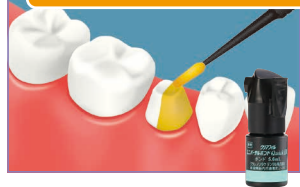
2 「カタナ® クリーナー」 10秒以上擦り塗布、 水洗※1・乾燥

10秒以上擦り塗布、水洗※1・乾燥



3 ボンド塗布・待ち時間なし でエアブローで 5秒以上乾燥※2

待ち時間なしでエアブロー



4 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンまたは高洞内に
ペースト塗布



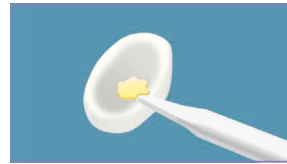
操作時間

操作時間(23°C)	1分
ペーストを高洞内に塗布した場合の操作時間(37°C)	30秒

① AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



② クラウンまたは
高洞内にペースト塗布



操作時間

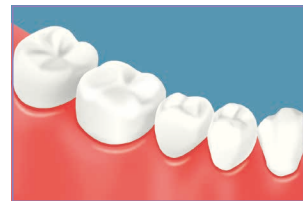
操作時間(23°C)	2分
ペーストを高洞内に塗布した場合の操作時間(37°C)	30秒

5 装着・余剰セメント の除去 ※3

1か所につき
1~2秒光照射



6 最終硬化 (5分保持) ※4



POINT

- ※1 色が完全になくなるまで水洗してください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。
- ※3 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。
- ※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(右表参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。



クリアフィル[®]
メガボンド[®] 2

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・ 充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液
(カリエスティテクター)が有効です。



2 プライマー塗布

20秒間処理



3 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥



4 ボンド塗布



5 マイルドなエアブローで均一に



6 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

7 光重合型CRの処理[※]



POINT

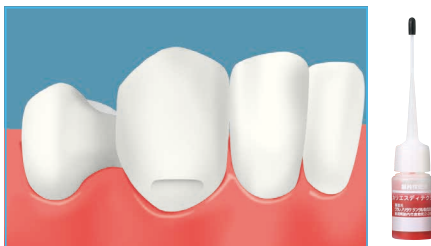
※ ご使用の光重合型CRの添付文書をご参照ください。



クリアフィル[®]
ユニバーサルボンド Quick ER

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・ 充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液
(カリエステクター)が有効です。



2 ボンド塗布

待ち時間なしで **3** へ



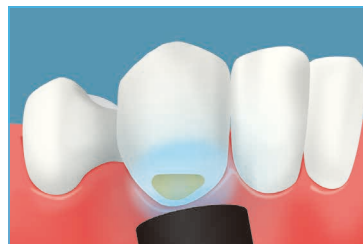
3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥^{※1}

5秒以上乾燥



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

5 光重合型CRの処理^{※2}



直接
充填

セメント
接着

支台
築造

リペア

知覚
過敏の
処置

歯面
コーティング

POINT

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※2 ご使用の光重合型CRの添付文書をご参照ください。

2-1 CAD/CAMレジン冠の接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

直接充填

セメント接着

支台築造

リヘア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

1 試適後、サンドブラスト処理※1・超音波洗浄・乾燥



2 「K エッチャント シリンジ」塗布、5秒後水洗・乾燥



5秒後水洗

3 シラン処理(「クリアフィル®セラミックプライマー プラス」塗布)・エアブローで乾燥



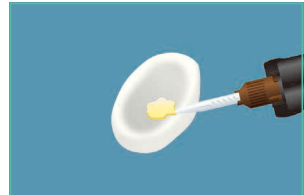
待ち時間なしでエアブロー

4 「パナビア® V5 トゥースプライマー」塗布※2、20秒処理後エアブローで乾燥



20秒

5 クラウンまたは窩洞内にペースト塗布



操作時間

操作時間(23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間(37℃)	60秒

6 装着・余剰セメントの除去

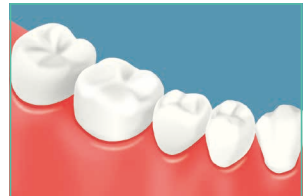
光照射で半硬化させる除去法	又は	小筆による除去法
<p>① 余剰セメントに1ヶ所につき3~5秒光照射</p> <p>3~5秒 オーバー</p>		<p>① 余剰セメントを小筆等で除去</p>
<p>② 探針等で除去</p>		<p>② マージン部に光照射</p> <p>マージンに光</p>

光照射については下記表をご参照ください。

7 最終硬化(3分保持)※3

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	



光量についてはP.2を参照ください。

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 支台歯(歯質、レジンコア、メタルコア)の一括処理が可能です。
- ※3 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。ただし、オーバーは光照射での最終硬化は行えません。

2-2 CAD/CAMレジン冠の接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER



SA ルーティング®
Multi

1 試適後、 サンドブラスト処理※1・ 超音波洗浄・乾燥



2 ボンド塗布



待ち時間なしで **3** へ

3 乾燥

マイルドなエアブローで
5秒以上乾燥※2



5秒以上乾燥

4 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンまたは窩洞内に
ペースト塗布



操作時間

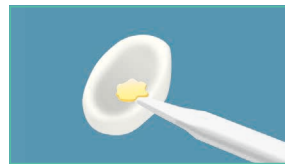
操作時間 (23°C)	1分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37°C)	30秒

1 AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



水分混入をさけるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

2 クラウンまたは
窩洞内にペースト塗布



操作時間

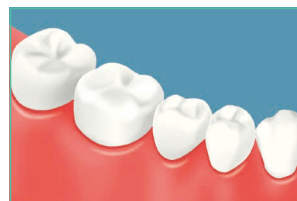
操作時間 (23°C)	2分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37°C)	30秒

5 装着・余剰セメント の除去※3

1か所につき
1~2秒光照射



6 最終硬化 (5分保持)※4



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。歯科セラミックス用接着材料を添付文書に従い適用することも可能です。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。

※3 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。

※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(右表参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

本術式は「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」添付文書記載の「セメント接着における補綴修復物の処理」「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」、及び「SA ルーティング® Multi」添付文書記載の「金属、シリコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

3-1 ジルコニアクラウンの接着

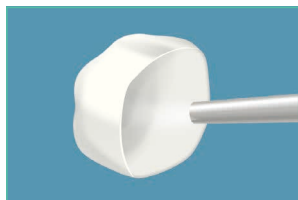


通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



パナビア® V5

- 1** 試適後、
サンドブラスト処理※1。
超音波洗浄・乾燥



- 2** 「クリアフィル® セラミック
プライマー プラス」塗布・
エアブローで乾燥



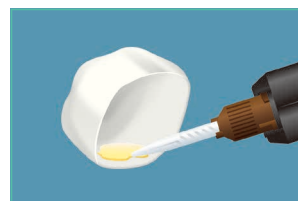
- 3** 「パナビア® V5 トゥース
プライマー」塗布※2、
20秒処理後エアブロー
で乾燥



- 4** クラウンまたは窩洞内に
ペースト塗布

操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37℃)	60秒



- 5** 装着・余剰セメントの除去

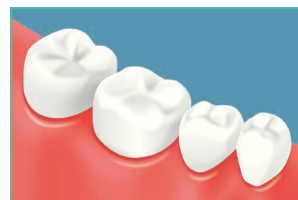
光照射で半硬化させる除去法	又は	小筆による除去法
<p>1 余剰セメントに1ヶ所につき3~5秒光照射</p> <p>3~5秒 オーバーク</p> <p>2 探針等で除去</p>		<p>1 余剰セメントを小筆等で除去</p> <p>2 マージン部に光照射</p> <p>マージンに光</p>

光照射については下記表をご参照ください。

- 6** 最終硬化(3分保持)※3

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

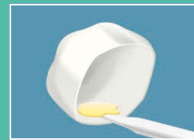


光量についてはP.2を参照ください。

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 支台歯(歯質、レジンコア、メタルコア)の一括処理が可能です。
- ※3 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。ただし、オーバークは光照射での最終硬化は行えません。

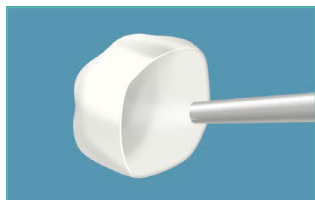
3-2 ジルコニアクラウンの接着



SAルーティング®
Multi

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

1 試適後、 サンドブラスト処理※1・ 超音波洗浄・乾燥



より高い接着力を求める場合

1 「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」塗布

待ち時間なしで 2へ



2 乾燥

マイルドなエアブローで
5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



2 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンまたは窩洞内に
ペースト塗布



操作時間

操作時間(23℃)	1分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間(37℃)	40秒

1 AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



水分混入をさげるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

2 クラウンまたは
窩洞内にペースト塗布



操作時間

操作時間(23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間(37℃)	40秒

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」を塗布した場合の操作時間は30秒

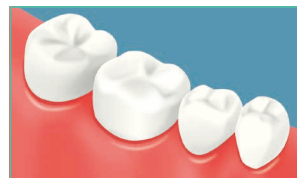
3 装着・余剰セメント の除去※3

1か所につき
2～5秒光照射



「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」を塗布した場合は1ヶ所につき1～2秒光照射

4 最終硬化 (5分保持)※4



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。

※3 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

本術式は「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」添付文書記載の「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」及び「SAルーティング® Multi」添付文書記載の「金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

4 ラミネートベニアの接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

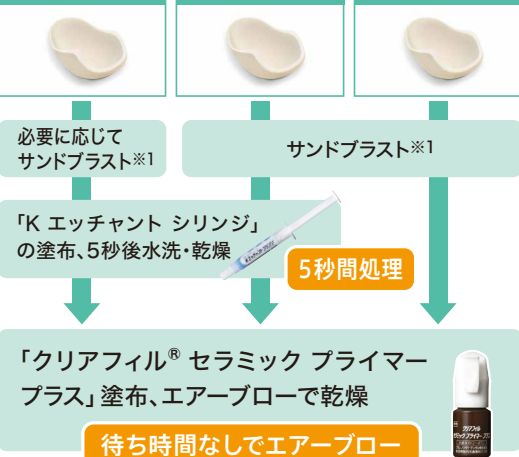


パナビア® ベニア LC

1 ラミネートベニアの表面処理

(使用可能な補綴装置の素材・厚みは、※2をご確認ください。)

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ①
シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の場合 | ②
無機物フィラーを含むレジン系材料の場合 | ③
ジルコニア等の金属酸化物系セラミックスの場合 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|



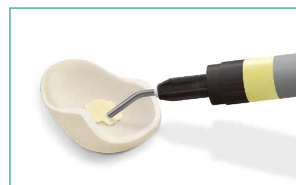
2 エナメル質に「Kエッチャント シリンジ」の塗布、10秒後水洗・乾燥



3 「パナビア® V5 トゥースプライマー」塗布、20秒処理後 エアブローで乾燥



4 ラミネートベニアの被着面全体にペースト塗布



5 装着・余剰ペーストの除去



6 光照射※2



※2 照射器と照射時間の関係

併用する材料及び色調	使用可能な補綴装置の厚み	歯科重合用照射器 (光量)		
		高出力LED照射器 (1500mW/cm²以上)	LED照射器 (1000~1400mW/cm²以上)	ハロゲン照射器 (400mW/cm²以上)
ラミネートベニア修復				
シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材	BLシェード、A1、A2、A3、A3.5、B1、B2 その他の色調	2.0mm未満	3秒×3回 又は 5秒×2回	10秒 20秒
無機物フィラーを含むレジン系材料	全ての色調	1.2mm未満	3秒×3回 又は 5秒×2回	20秒
ノリタケ カタナ® ジルコニア STML/UTML/YML、カタナ® ジルコニア ブロック STML				

POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は添付文書にしたがってください。

本術式は「パナビア® ベニア LC」添付文書記載の「使用方法」を示します。

直接充填

セメント接着

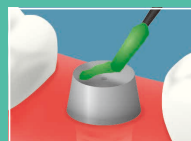
支台築造

リベア

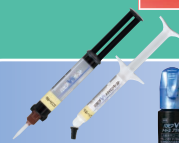
知覚過敏の処置

歯面コーティング

インプラントアバットメントへの 補綴装置の接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



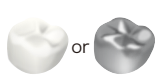
パナビア® V5

1 補綴装置の処理

無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の場合



金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックスの場合



必要に応じて
サンドブラスト※1

サンドブラスト※1

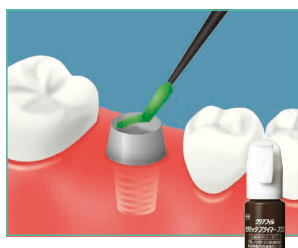
K エッチャント
シリンジの塗布、
5秒後水洗・
乾燥

5秒間処理

「クリアフィル® セラミック
プライマー プラス」塗布、
エアブローで乾燥

待ち時間なしでエアブロー

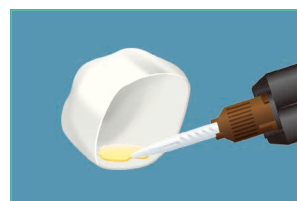
2 アバットメントへの 「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」塗布・ マイルドなエアブローで乾燥



3 補綴装置へのペースト塗布

操作時間

操作時間 (23°C)	2分
-------------	----



4 装着・余剰セメントの除去

光照射で半硬化させる
除去法

又は

小筆による除去法

① 余剰セメントに1ヶ所につき
3~5秒光照射



3~5秒
オ×ク

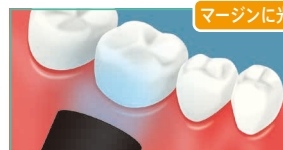
② 探針等で除去



① 余剰セメントを小筆等で
除去



② マージン部に光照射



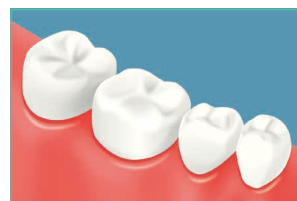
マージンに光

光照射については下記表をご参照ください。

5 最終硬化※2

保持時間

37°C	5分
23°C	10分



POINT

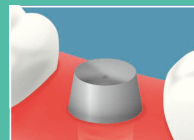
※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。

※2 光を透過する補綴装置の場合はマージン部を含む補綴装置全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。ただしオパークは光照射での最終硬化は行えません。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

SAルーティング®
Multi

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

1 補綴装置の処理

無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の場合



必要に応じて
サンドブラスト※1

金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックスの場合



サンドブラスト※1

2 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンにペースト塗布



操作時間

操作時間(23°C) 1分

① AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



10秒

水分混入をさけるため練和紙、練和棒は冷蔵保管しない

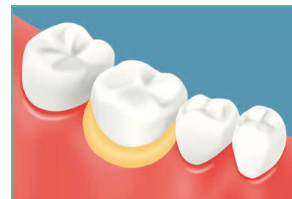
② クラウンにペースト塗布



操作時間

操作時間(23°C) 2分

3 補綴装置の装着

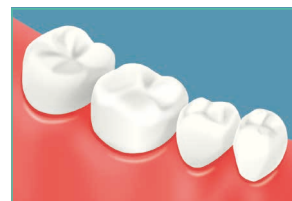


4 余剰セメントの除去※2



1か所につき2~5秒光照射

5 最終硬化(5分保持)※3



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。

※2 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。

※3 光を透過する補綴装置の場合補綴装置全体及びマージン部への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

光量についてはP.2を参照ください。

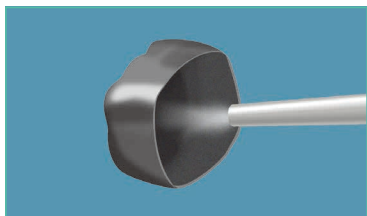
6 金属冠、前装冠の接着



SA ルーティング®
Multi

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

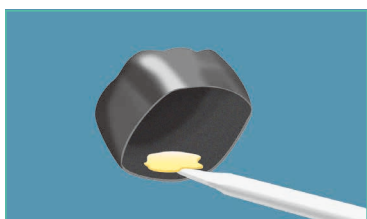
1 試適後、サンドブラスト処理※1 超音波洗浄・乾燥



2 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和



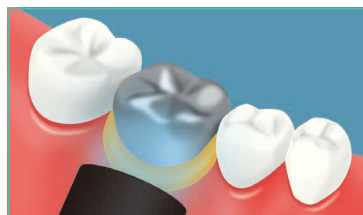
3 クラウンまたは 窩洞内にペースト塗布



操作時間

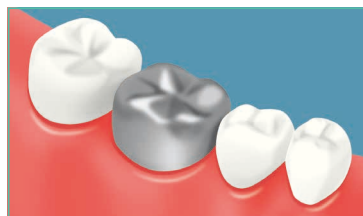
操作時間(23°C)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間(37°C)	40秒

4 装着・余剰セメントの除去※2



1か所につき2~5秒光照射

5 最終硬化(5分保持)



直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。

※2 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

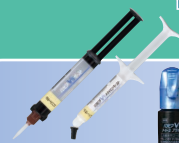
光量についてはP.2を参照ください。

本術式は「SA ルーティング® Multi」添付文書記載の「金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

7-1 レジンコアの接着



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。



パナビア® V5

1 レジンコアの表面処理

1 サンドブラスト処理※1、超音波洗浄・乾燥

2 「K エッチャント シリンジ」塗布、5秒後水洗・乾燥

5秒間処理

3 シラン処理「クリアフィル®セラミックプライマープラス」塗布エアブローで乾燥

待ち時間なしでエアブロー

2 「パナビア® V5 トゥース プライマー」塗布、20秒処理後乾燥※2



3 コアの被着面または築造窩洞内へペーストを注入



築造窩洞内へ注入した場合は60秒以内に **4** へ

4 レジンコアの装着※3、余剰セメント除去

照射で半硬化させる除去法

1 余剰セメントに1ヶ所につき3~5秒照射

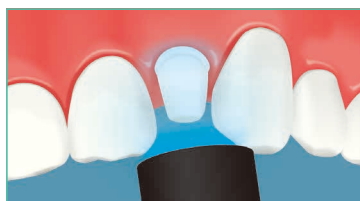
3~5秒
~~オーバー~~

2 探針等で除去

又は 小筆による除去法

余剰セメントを小筆等で除去

5 マージン部に光照射※4



オーバーの場合はさらに3分保持

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

6 支台歯形成

6分保持し形成



POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 余剰のプライマーをペーパーポイント等で吸い取った後、エアブローで乾燥してください。
- ※3 気泡の混入にご注意ください。
- ※4 1回の光照射で、光硬化させる部位全てが照射径に入らない場合は、光照射を繰り返して全ての部位に対して光照射を行ってください。

7-2 レジンコアの接着

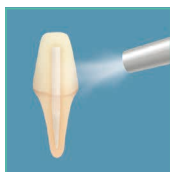


SAルーティング®
Multi

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。

1 レジンコアの表面処理

サンドブラスト処理※1
超音波洗浄・乾燥



より高い接着力を求める場合

①「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」塗布

待ち時間なしで ②へ



② 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



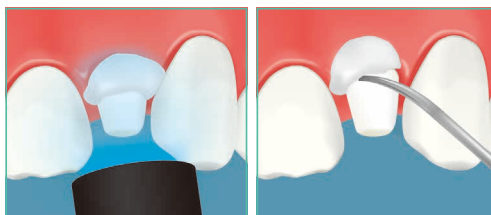
2 コアの被着面または築造窩洞内へペーストを注入



築造窩洞内へ注入した場合は40秒以内に ③へ

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」を塗布した場合は30秒以内に ③へ

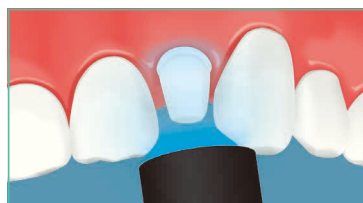
3 コアの装着※3、余剰セメント除去※4



1か所につき2~5秒光照射

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」を塗布した場合は1ヶ所につき1~2秒光照射

4 マージン部に光照射



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

5 支台歯形成

10分保持し形成



POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※3 気泡の混入にご注意ください。
- ※4 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。

本術式は「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」添付文書記載の「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」及び「SAルーティング® Multi」添付文書記載の「金属コア、レジンコア、金属ポスト、グラスファイバーポストの接着」を示します。

直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

memo

直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

8

直接法レジンコア【ファイバーポスト】



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER



クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

1 ポストの表面処理

① リン酸処理
水洗・乾燥

5秒間処理



例えば

② シラン処理(「クリアフィル® セラミックプライマー プラス」塗布・エアブローで乾燥

待ち時間なしでエアブロー



2 ボンド塗布

待ち時間なしで③へ



3 マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※1

5秒以上乾燥



4 光照射



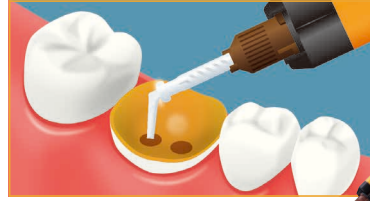
ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

5 ペーストの填入※2



6 ポスト植立・光照射



「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)」参照

7 ペーストの築盛・光照射※3,4.

支台歯形成



ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

POINT

- ※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※2 ポストの植立は1分以内に行ってください。
- ※3 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。
- ※4 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。

直接法レジンコア【ファイバーポスト】

(デュアルキュア型/セルフキュア型 支台築造用レジン)



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



クリアフィル®
メガボンド® 2



クリアフィル®
ポーセレンボンド
アクティベーター



クリアフィル®
DCアクティベーター

「クリアフィル® メガボンド® 2」は「クリアフィル® DCアクティベーター」と混和し、デュアルキュア型/セルフキュア型支台築造材料の接着に使用できます。

1 ポストの表面処理

- ① リン酸処理
水洗・乾燥
5秒間処理



例えば

- ② プライマーと「クリア
フィル® ポーセレンボ
ンドアクティベーター」
の混和液※1 塗布・エ
アープローで乾燥



2 プライマー塗布、乾燥

20秒処理後、マイルドなエアープローで
5秒以上乾燥

20秒処理後 → 5秒以上乾燥



3 ボンドと「クリアフィル® DCアクティベーター」の 混和液※1 塗布



4 乾燥

マイルドなエアープローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



5 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

「ベンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元: 株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

6 ポスト植立及び/又は支台築造※3



POINT

- ※1 1滴ずつ等量混和してください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。根管内に残った余剰液はペーパーポイントなどで除去し、その後再度エアープローで乾燥してください。
- ※3 使用する材料の添付文書をご参照ください。



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER



クリアフィル®
DCアクティベーター

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」は「クリアフィル® DCアクティベーター」と混和し、デュアルキュア型/セルフキュア型支台築造材料の接着に使用できます。

1 ポストの表面処理

- ① リン酸処理
5秒後、水洗・乾燥
5秒間処理



- ② シラン処理(「クリアフィル® セラミックプライマー プラス」)塗布・エアブローで乾燥



待ち時間なしでエアブロー

2 ボンドと「クリアフィル® DCアクティベーター」の混和液※1 塗布

待ち時間なしで③へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

5 ポスト植立及び/又は支台築造※3



POINT

※1 1滴ずつ等量混和してください。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰液はペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。

※3 使用する材料の添付文書をご参照ください。

10 直接法レジンコア【金属ポスト】



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER



クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

1 ポストの表面処理

サンドブラスト※1
ボンド塗布・エア
ブローで乾燥

ボンド塗布・乾燥



2 ボンド塗布

待ち時間なしで [3] へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



4 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒(製造販売元・株式会社 モリタ製作所)



5 ペーストの填入※3



6 ポスト植立・光照射



「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)」参照

7 ペーストの築盛・光照射※4,5. 支台歯形成



ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

POINT

- ※1 使用する材料の添付文書をご参照ください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※3 ポストの植立は1分以内に行ってください。
- ※4 舌側と唇側の2方向より所定時間照射してください。
- ※5 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」添付文書記載の「歯科用ポストの表面処理」「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料によるポストの植立及び/又は支台築造」及び「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」添付文書記載の「直接法による支台築造」を示します。

11 間接法レジンコア【ファイバーポスト】



クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞の形成、印象採得等を行ってください。

1 模型を製作



2 ポストの試適、切断、清掃



3 ポストの表面処理

① リン酸処理
5秒後、水洗・乾燥
5秒間処理



例えば

② シラン処理(「クリアフィル® セラミックプライマー プラス」塗布・エアブローで乾燥)



待ち時間なしでエアブロー

4 分離材を塗布



5 ペーストの填入



6 ポスト植立・光照射



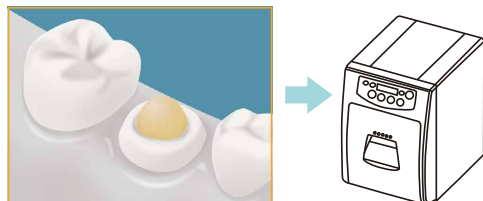
光照射については下記表をご参照ください。

7 ペースト築盛



操作可能時間 (23℃遮光下) ミキシングチップを通して練和開始後3分

8 光照射※・支台歯形成



光照射については下記表をご参照ください。

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	照射時間	硬化深度
アルファライトII ¹⁾	120秒	3.0mm
アルファライトIIIN ¹⁾		5.0mm
アルファライトIII ¹⁾	180秒	5.0mm

1) 製造販売元:株式会社モリタ 東京製作所

POINT ※ 光硬化深度以上に築盛する場合は10分以上静置してください。

本術式は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」添付文書記載の「間接法による支台築造」を示します。

直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポスの試適、切断等を行ってください。



1 ポスの表面処理

- ① リン酸処理
5秒後、水洗・乾燥
5秒間処理



- ② シラン処理(「クリアフィ
ル® セラミックプライ
マー プラス」)塗布・エ
アープローで乾燥



待ち時間なしでエアープロー

2 「パナビア® V5 トゥース プライマー」 の塗布・20秒間処理



3 余剰プライマーの除去・ エアープローで乾燥 ※1



4 ペーストの塗布、ポスの挿入 ※2,3



操作時間

操作時間(23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間(37℃)	60秒

5 光照射 ※4

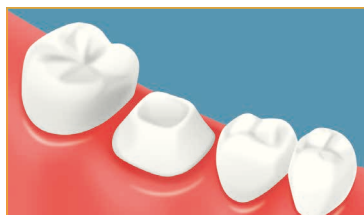


照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

6 支台築造材料 ※5 による支台築造・ 支台歯形成 ※6



POINT

- ※1 余剰プライマーはペーパーポイント等で吸い取った後、バキュームで吸引しながら乾燥してください。
- ※2 気泡の混入にご注意ください。
- ※3 余剰ペーストは残存歯冠、ポスのヘッド部に広げてください。
- ※4 オペークの場合は3分間保持してください。
- ※5 使用する材料の添付文書をご参照ください。
- ※6 支台歯形成は植立から6分以上経過した後に行ってください。

セメントによる ファイバーポスの植立



SAルーティング®
Multi

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。

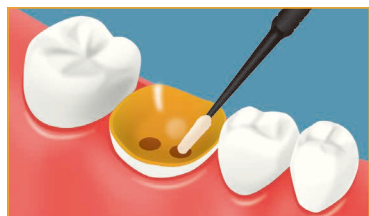
より高い接着力を求める場合

- ① 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」塗布



待ち時間なしで ② へ

- ② 余剰ボンドの除去・
エアブローで乾燥



- ① ペーストの塗布、ポストの挿入 ※1,2



操作時間

操作時間 (23°C)	1分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37°C)	40秒

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」を塗布した場合は30秒以内に②へ

- ② 光照射 ※3

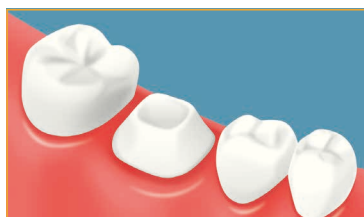


照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

- ③ 支台築造材料 ※4 による支台築造・
支台歯形成 ※5



直接充填

セメント接着

支台築造

リヘア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

POINT

- ※1 気泡の混入にご注意ください。
- ※2 余剰ペーストは残存歯冠、ポストのヘッド部に広げてください。
- ※3 残存歯冠やポストのヘッド部に対して各面につき光照射してください。
- ※4 使用する材料の添付文書をご参照ください。
- ※5 支台歯形成は植立から10分以上経過した後に行ってください。

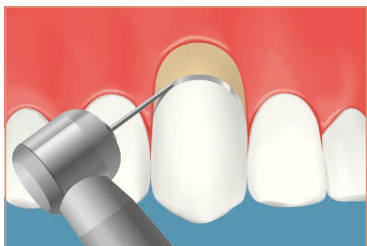


クリアフィル® ポーセレンボンド
アクティベーター



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER

1 被着面の粗造化、水洗、乾燥



2 リン酸処理、5秒後水洗、乾燥



3 ボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンドアクティベーター」 の混和液※1,2 塗布

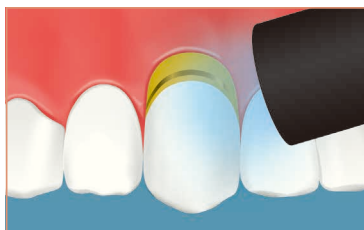


4 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※3



5 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

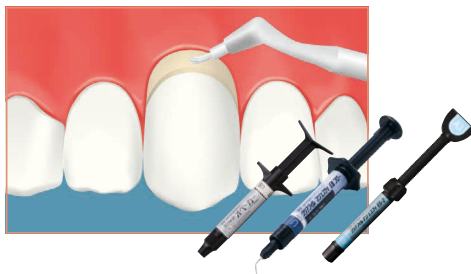
分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ベンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

6 光重合型CRの充填、光照射、研磨※4

メタル部のマスキングには「クリアフィル® ST
オペレーター」をご使用ください。



POINT

※1 粗造化が困難な貴金属面に対しては、「アロイプライマー」を添付文書にしたがひ塗布、乾燥した後にボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」の混和液を塗布してください。

※2 1滴ずつ等量混和してください。

※3 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※4 ご使用の色調遮蔽材料、光重合型CRの添付文書をご参照ください。

口腔内リペア【歯質を含まない場合】

(例えば、金属・陶材・コンポジットレジン)

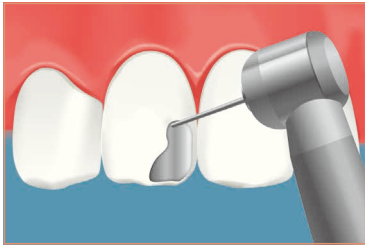


クリアフィル®
セラミック プライマー プラス



クリアフィル®
ST オペーカー

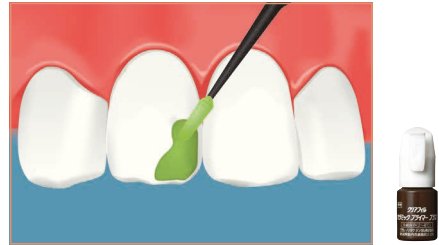
1 防湿、被着面の粗造化、水洗、乾燥



2 被着面のリン酸処理、5秒後水洗い、乾燥



3 「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」の塗布



4 金属面に「クリアフィル® ST オペーカー」を塗布(0.5mm以下)・光照射(下記表参照)その後、光重合型CRの処理※



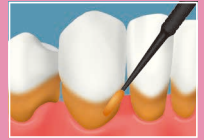
「クリアフィル® ST オペーカー」の照射時間

歯科用可視光線照射器	光量	材料の厚さ (mm)	
		~0.4	0.4~0.5
従来型ハロゲン照射器	150~550mW/cm ²	40秒	60秒
高出力ハロゲン照射器	550mW/cm ² 以上	10秒	20秒
プラズマアーク照射器	2000mW/cm ² 以上 (400~515 nm) 且つ 450mW/cm ² 以上 (400~435 nm)	5秒	5秒
LED照射器	120mW/cm ² 以上	40秒	80秒

POINT ※ 使用する材料の添付文書をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® ST オペーカー」添付文書記載の「前装冠の補修(破折した前装冠の補修時における金属色の遮蔽)(歯肉の退縮した前装冠補修時の歯根色と金属色の遮蔽)」及び「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」添付文書記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる歯冠修復物(前装冠等)の補修」を示します。

15-1 知覚過敏の処置



クリアフィル®
メガボンド® 2

直接充填

セメント接着

支台築造

リベア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

- 1 患部の診察・歯面清掃・防湿
患部全体にプライマー塗布
20秒間処理**



- 2 乾燥(弱～中圧)**
マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※



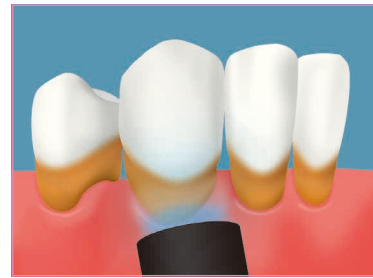
- 3 ボンド塗布**



- 4 乾燥**
マイルドなエアブローで均一に



- 5 光照射**



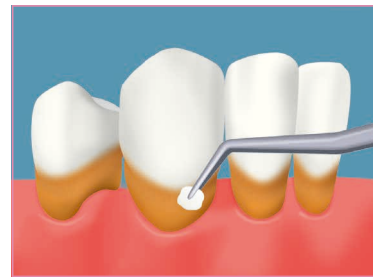
ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ベンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

- 6 未重合層の除去**



POINT ※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル®メガボンド®2」添付文書記載の「知覚過敏歯の処置」を示します。

15-2 知覚過敏の処置



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER

1 患部の診察・歯面清掃・防湿 患部全体にボンド塗布



2 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアブローで液面が
動かなくなるまで乾燥※



3 光照射



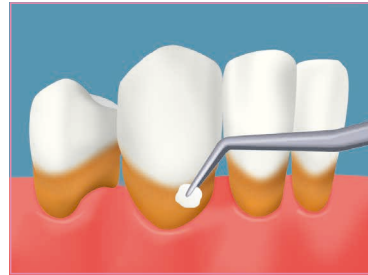
ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ベンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

4 未重合層の除去



直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

POINT ※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」添付文書記載の「知覚過敏の処置」を示します。

15-3 知覚過敏の処置



ティースメイト®
ディセンシタイザー

通法にしたがい歯面を清掃します。患部の唾液、プラークは綿球等で拭き取り、過剰に付着したプラーク、ステインは、歯面研磨剤等で清掃します。

乾燥の必要なし

1 液材採取、粉材採取、混和^{※1}

15秒以上混和

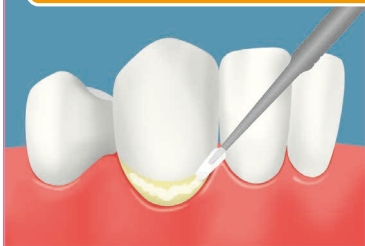


標準粉液比

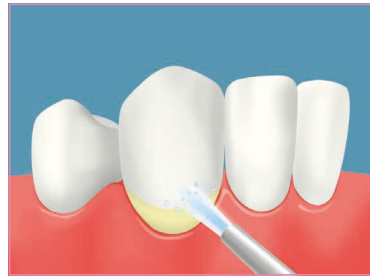
	液材	粉材
1歯分	1滴	計量スプーン 小1杯
2~3歯分	2滴	計量スプーン 大1杯

2 ペーストのこすり塗り

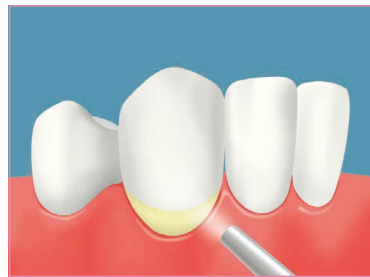
一歯当たり30秒以上こすり塗り



3 水洗^{※2}



4 効果の確認^{※3}



POINT

- ※1 液材は容器を垂直に立てること。粉材は採取前に容器を軽く振り、内蓋でこすり切ること。
- ※2 余剰ペーストを水洗又はうがい等で取り除きます。
- ※3 知覚過敏症状が消退していない場合は、2、3を繰り返してください。

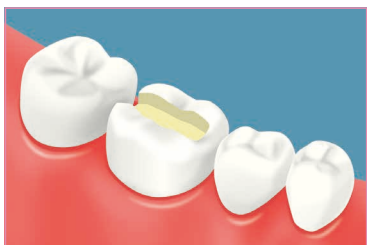
本術式は「ティースメイト® ディセンシタイザー」添付文書記載の「歯ブラシ磨耗、歯肉後退、歯周炎、歯牙酸蝕等によって露出した象牙質の処置」「機械的歯面清掃、スクーリング、ルートプレーニング後の象牙質の処置」「漂白処置後の歯面の処置」を示します。

16 形成象牙質の処置



ティースメイト®
ディセンシタイザー

1 窩洞、支台歯の形成、清掃、消毒



乾燥の必要なし

2 液材採取、粉材採取、混和※1

15秒以上混和



標準粉液比

	液材	粉材
1歯分	1滴	計量スプーン 小1杯
2~3歯分	2滴	計量スプーン 大1杯

3 ペーストのこすり塗り

一歯当たり30秒以上こすり塗り



4 水洗※2

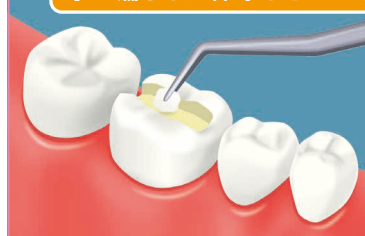


5 効果の確認※3



6 処置後の形成象牙質の清掃※4

水で濡らした綿球などで10秒以上



7 修復治療・補綴治療※5

POINT

- ※1 液材は容器を垂直に立てること。粉材は採取前に容器を軽く振り、内蓋でこすり切ること。
- ※2 余剰ペーストを水洗又はうがい等で取り除きます。
- ※3 知覚過敏症状が消退していない場合は、2、3を繰り返してください。
- ※4 形成象牙質表面に僅かに残存するペーストの微小粒子を取り除きます。
- ※5 使用する材料の添付文書をご参照ください。

各種処置後のしみ止め

(機械的歯面清掃、スケーリング、ルートプレーニング後、漂白処置後の歯面の処置)

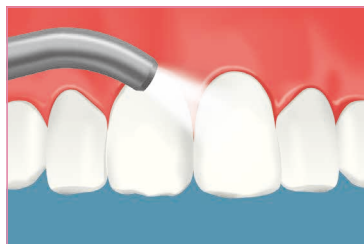


ティースメイト®
APペースト

1 患部の診察・歯面清掃・ペースト採取



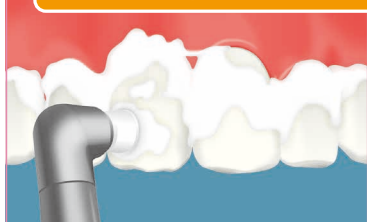
4 効果の確認※2



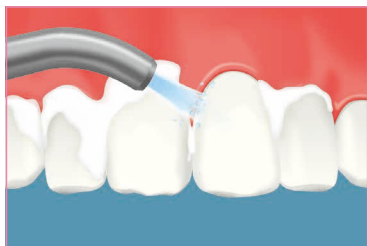
乾燥の必要なし

2 ペーストの擦り塗り

1歯あたり20秒以上こすり塗り



3 水洗※1



POINT

- ※1 余剰ペーストを水洗又はうがい等で取り除きます。
- ※2 症状が消滅していない場合は再度ペーストを擦り塗ります。

18 象牙質レジンコーティング



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER

1 支台歯形成、防湿、歯髄保護 支台歯全体にボンド塗布



2 乾燥(弱～中圧) マイルドなエアブローで 5秒以上乾燥※1



3 光照射



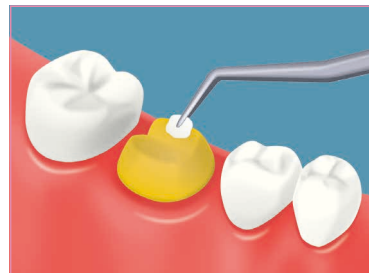
ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ベンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

4 未重合層の除去・完了※2



POINT

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。

※2 レジン系の仮着材、仮封材を用いる場合は、コーティング面に接着する恐れがあるため、必ず歯科用分離材をご使用ください。歯科用分離材の使用方法は、当該品の添付文書にしたがってください。

● ボンディング材

管理医療機器 歯科用象牙質接着材
(歯科セラミックス用接着材料) (歯科金属用接着材料)
(歯科用知覚過敏抑制材料)

クリアフィル メガボンド²

医療機器認証番号: 227ABBZX00114000

【セット】



管理医療機器 歯科用象牙質接着材
(歯科セラミックス用接着材料) (歯科金属用接着材料)
(歯科用知覚過敏抑制材料) (歯科用シーリング・コーティング材)

クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER

医療機器認証番号: 228ABBZX00065000

【単品】



● セメント

管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア[®] V5

医療機器認証番号: 226ABBZX00106000

【スターターキット】ユニバーサル



管理医療機器 歯科用セメントキット

パナビア[®] ベニア LC

医療機器認証番号: 303ABBZX00060000

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント
パナビア[®] ベニア LC ペースト

医療機器認証番号: 303ABBZX00035000

【単品】ユニバーサル / クリア / ブラウン / プリーチ



管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

SA ルーティング[®] Multi

医療機器認証番号: 230ABBZX00096000

オートミックス

【バリューキット】ユニバーサル

【単品】ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント



単品

ハンドミックス

【バリューキット】ユニバーサル

【単品】ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント



バリューキット

● コンポジットレジン

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル マジエスティ ES フロー

医療機器認証番号: 224ABBZX00170000

【単品】Super Low / Low / High



管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル マジエスティ ES-2

医療機器認証番号: 224ABBZX00119000

【単品】



管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料

クリアフィル ST オペーカー

医療機器承認番号: 16200BZZ00980000

【単品】



● 支台築造

管理医療機器 歯科用支台築造材料

クリアフィル® DC37 オートミックス ONE

医療機器認証番号: 223ABBZX00086000

【単品】デンチン/ホワイト



管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品

クリアフィル® AD ファイバーポスト II

医療機器認証番号: 301ABBZX00019000

【30本入】

【単品】



● 知覚過敏抑制材・その他の材料

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

カタナ® クリーナー

医療機器認証番号: 301ABBZX00015000

【単品】



管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料

ティースメイト® ディセンシタイザー

医療機器認証番号: 224ABBZX00014000

【1-1セット】



管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料

ティースメイト® APペースト

医療機器認証番号: 226ABBZX00010000

【単品】



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)

クリアフィル® セラミックプライマー プラス

医療機器認証番号: 226ABBZX00105000

【単品】



管理医療機器 歯科用象牙質接着材

クリアフィル® DC アクティベーター

医療機器認証番号: 228ABBZX00066000

【単品】



管理医療機器 歯科用エッチング材

KETCHANT シリジ

医療機器認証番号: 226ABBZX00089000

【単品】



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料) (歯科用象牙質接着材) (歯面処理材)

クリアフィル® ボーセレンボンド アクティベーター

医療機器承認番号: 16300BZZ00085000

【単品】



● 使用ステップをスマートフォンやPCで見たい方に

セメント接着

セメンテーションガイド

使用する接着材料と、補綴装置の素材、支台歯の素材を選択すると、適した接着ステップが表示されるガイドツールです。

こちらから
アクセス!



支台築造

支台築造早わかりガイド

直接法/間接法や、使用する材料を選択すると、適した支台築造のステップが表示されるガイドツールです。

こちらから
アクセス!



● 最新の情報を知りたい方に

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

新製品の発売や製品リニューアルの情報をいち早くお届けしています。また、使い方や特長を動画でわかりやすく説明したショートムービーなどもご覧いただけます。



LINEで
友達登録!



クラレノリタケデンタル 公式アプリ

「早わかりフローチャート」や製品カタログをスマートフォンで閲覧することができます。また、最新の情報をプッシュ通知でお届けします。



ダウンロードは
こちら



● わからないことがある時に

クラレノリタケデンタル 製品サポートページ

よくあるお問い合わせをまとめたページです。キーワードで検索することもできます。動画や画像で解説しているページもあります。




ダウンロードは
こちら



●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

 **0120-330-922**

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー
フリーダイヤル：0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)
<https://www.dental-plaza.com>

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

クラレノリタケデンタル公式アプリ



クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS13.7 以上 / Android9.0 以上